

## パッケージ : iPhone Air ディスプレイ用FPC搭載パッケージ構造解析 レポート（企画）



iPhone Air



iPhone 16 Pro Max

### レポート概要

本企画では、iPhone Airに搭載されているディスプレイ用FPC (Flexible Printed Circuit) 上の実装部品に着目した構造解析レポートを計画しています。

### 製品特徴

iPhone Airのディスプレイは、6.5インチのSuper Retina XDR OLEDで、Apple初の“極薄・高輝度・高効率”設計を実現した新世代パネルです。

旧モデルではディスプレイ用FPCにタッチスクリーンコントローラ用と受動素子用の2パッケージ構成で部品が実装されておりましたが、本モデルでは1パッケージ内の基板に両面実装することでそれらが統合され、実装部品点数が削減しております。

### 解析内容、レポート価格

構造解析レポート：価格 ¥230,000（税別）

納期：企画成立後 2週間

- FPC、パッケージの断面観察
- X線観察